ファインセラミックスの限りない可能性を求めて

ニホンファインセラミックス
日本ファインセラミックス 株式会社

ホームページQRコード

鋳造・ダイカスト
鍛造
プレス
樹脂成形
ゴム成型
電装品
表面処理
縫製・皮革
機械加工
ばね
金型・治工具
自動機
製缶・板金
ソフトウェア
その他

事業・商品・技術の特徴

技術の特徴
- セラミックスの基礎・応用研究、製品の用途開発
- 原料調合から製品加工まで一貫生産対応

事業の紹介

◇電子材料事業
- セラミックス基板（高品位アルミナ基板、マイクロ波用誘電体基板、ジルコニア基板、高熱伝導窒化珪素基板）
- 薄膜集積回路（光通信用、マイクロ波・ミリ波用）

◇構造材料事業
- 一般産業機械用セラミックス部品（ポンプ部品、耐熱部品、各種治工具類など）
- 精密製造装置用セラミックス部品（半導体・FPD・LED製造装置用部品など）

◇MMC事業；金属セラミックス複合材料
- 精密製造装置用部品（半導体・FPD製造装置用部品、チップマウンター用部品、大型機械部品、各種鋳造製品など）

◇受託加工事業

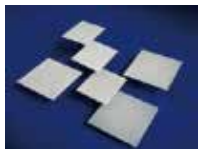
連絡先

Tel	03-5297-1321（東京営業所）
Fax	03-5297-0733（東京営業所）
E-Mail	seihin@japan-fc.co.jp
URL	https://www.japan-fc.co.jp/
担当者役職・氏名／	営業本部

構造材料

MMC

電子材料

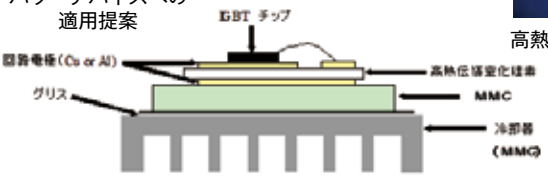

高熱伝導窒化珪素基板

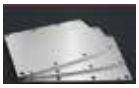
イチ押し！車技術

◇金型の長寿命化に！
- 窒化珪素セラミックス製金型部材
  - 高靭性（7MPa·m$^{1/2}$）
  - 高耐熱衝撃性（800K）

◇電装品の軽量化・放熱対策に！
- 高熱伝導窒化珪素基板
  - 高熱伝導（90W/m·K）
  - 高強度（曲げ700MPa）
  - 薄板（最大板厚　0.32mm）
- MMC放熱板・筐体
  - 高熱伝導（130 ～ 180W/m·K）
  - 低熱膨張（7 ～ 15 × 10^{-6}/K）
  - 低比重（3g/cm^3）
  - ※要求特性に応じた材料提案が可能

パワーデバイスへの適用提案




MMC放熱基板

生産品目等

品　目	車以外		
	薄膜集積回路	一般産業機械用部品	精密製造装置用部品
ロット	–	–	–
サイズ	–	–	–
精　度	–	–	–
材　質	–	–	–
取引先	–	–	–
売上比率（%）	–	–	–

生産設備（主な機械加工設備）

名　称	型式・能力	台数
旋盤（汎用　NC）	CL-150M 他	33
マシニングセンタ／グライディングセンタ	SV10000 他	62
五面加工マシニングセンタ	MCR-BⅡ	6
平面研削盤	PSG-150DX 他	39
円筒研削盤類（万能　CNC　内面）	GL4P-50 他	36
ロータリー研削盤	PRG-6DXNC 他	13
ラップ・ポリッシュ（両面　片面）	9B-5DPG 他	49
ダイシングソー／スライサー	DAD2H/6型 他	9
レーザー加工機	YB-255LCA-2 他	6
ワイヤー放電加工機	U53K	2

企業概要

本　　社	〒981-3206 仙台市泉区明通3-10	
宮城の拠点	（本社工場）同上 （MMC第１工場）仙台市泉区明通3-7 （MMC第２工場）仙台市泉区明通3-14 （富谷工場）富谷市高屋敷２番地	
面　　積	【敷地】51,000㎡ / 【建物】19,000㎡	
海外拠点	―	
代表者	代表取締役社長　田中　宏	
設　　立	1984年（S59）	従業員
資本金	3億円	460名
認証取得	ISO9001/14001	
資格取得	―	

業務範囲	素　材	企画／開発	設　計	試作／小ロット	量　産	組立／検査	評　価	設備メンテ等